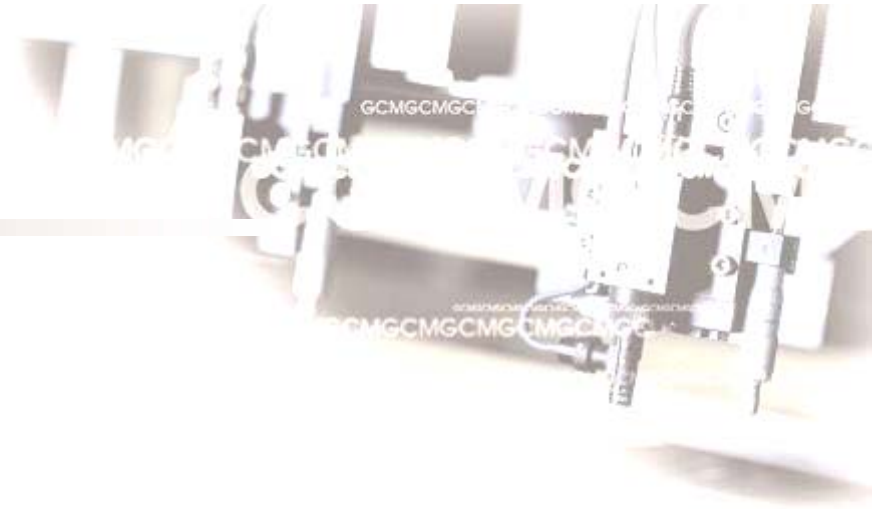


2010年2月期決算説明会資料

2010年4月19日

RORZE CORPORATION



2010年2月期 決算概要

2010年2月期 連結損益計算書

(百万円)

	2009年2月期 実績	2010年2月期 実績	増減率	増減理由等
売上高	8,377	3,610	△56.9%	<p>【減少要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・前期に引続き、世界的な半導体や液晶関連の設備投資が大幅に減少 ・特に、日本のウエハ搬送装置、並びに韓国のがラス基板搬送装置の受注が低調に推移 <p>【増加要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・一方、台湾における半導体設備投資の回復により、下半期から受注が増加
売上総利益	1,836	327	△82.2%	<p>【減少要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・当社並びに韓国子会社の大幅な減収と、それに伴うベトナム生産子会社の生産量・生産性の低下 等 <p>【増加要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・台湾子会社の売上増加、固定費削減 等
販管費	1,681	1,442	△14.2%	<p>【減少要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人件費を中心とした固定費削減 ・減収に伴う販売関連費用(旅費・販促費等)の減少等
営業利益又は 営業損失(△)	154	△1,115	—%	
経常利益又は 経常損失(△)	152	△953	—%	(営業外損益の増減につきましては、決算短信をご参照下さい)
当期純損失 (△)	△34	△663	—%	(特別損益の増減につきましては、決算短信をご参照下さい)

2010年2月期 連結貸借対照表

(百万円)

	2009年2月期実績	2010年2月期実績	増減額	増減理由等
流動資産	8,805	7,666	△1,139	<ul style="list-style-type: none"> ・現金及び預金 △180 ・受取手形及び売掛金 △636 ・たな卸資産 △318
固定資産等	6,844	6,806	△37	<ul style="list-style-type: none"> ・建物及び構築物 +145 ・機械装置 + 83 ・建設仮勘定 △371 ・その他(有形固定資産) +129 ・減価償却累計額 △342 ・投資有価証券 +158 ・繰延税金資産 +176 ・開発費 △93
資産合計	15,649	14,472	△1,177	
流動負債	5,571	5,158	△413	<ul style="list-style-type: none"> ・支払手形及び買掛金 △131 ・短期借入金 △502 ・製品保証引当金 △88 ・その他 +352
固定負債	2,116	2,112	△4	<ul style="list-style-type: none"> ・長期借入金 +107 ・繰延税金負債 △125
負債合計	7,688	7,270	△418	
株主資本	8,186	7,336	△849	<ul style="list-style-type: none"> ・利益剰余金 △751 ・自己株式 △98
評価・換算差額等	△1,283	△1,125	157	<ul style="list-style-type: none"> ・為替換算調整勘定 +141
新株予約権	—	11	11	
少数株主持分	1,057	979	△78	<ul style="list-style-type: none"> ・少数株主持分(主に韓国子会社) △78
純資産合計	7,960	7,202	△758	
負債純資産合計	15,649	14,472	△1,177	

2010年2月期 連結キャッシュ・フロー

(百万円)

	2009年2月期 実績	2010年2月期 実績	増減額
営業活動による キャッシュ・フロー	1,720	387	△1,332
投資活動による キャッシュ・フロー	△193	4	198
財務活動による キャッシュ・フロー	△931	△551	379
現金及び現金同等物 に係る換算差額	△322	62	385
現金及び現金同等物 の減少額	272	△96	△369
現金及び現金同等物 の期首残高	2,086	2,359	272
現金及び現金同等物 の期末残高	2,359	2,262	△96

2010年2月期 個別損益計算書

(百万円)

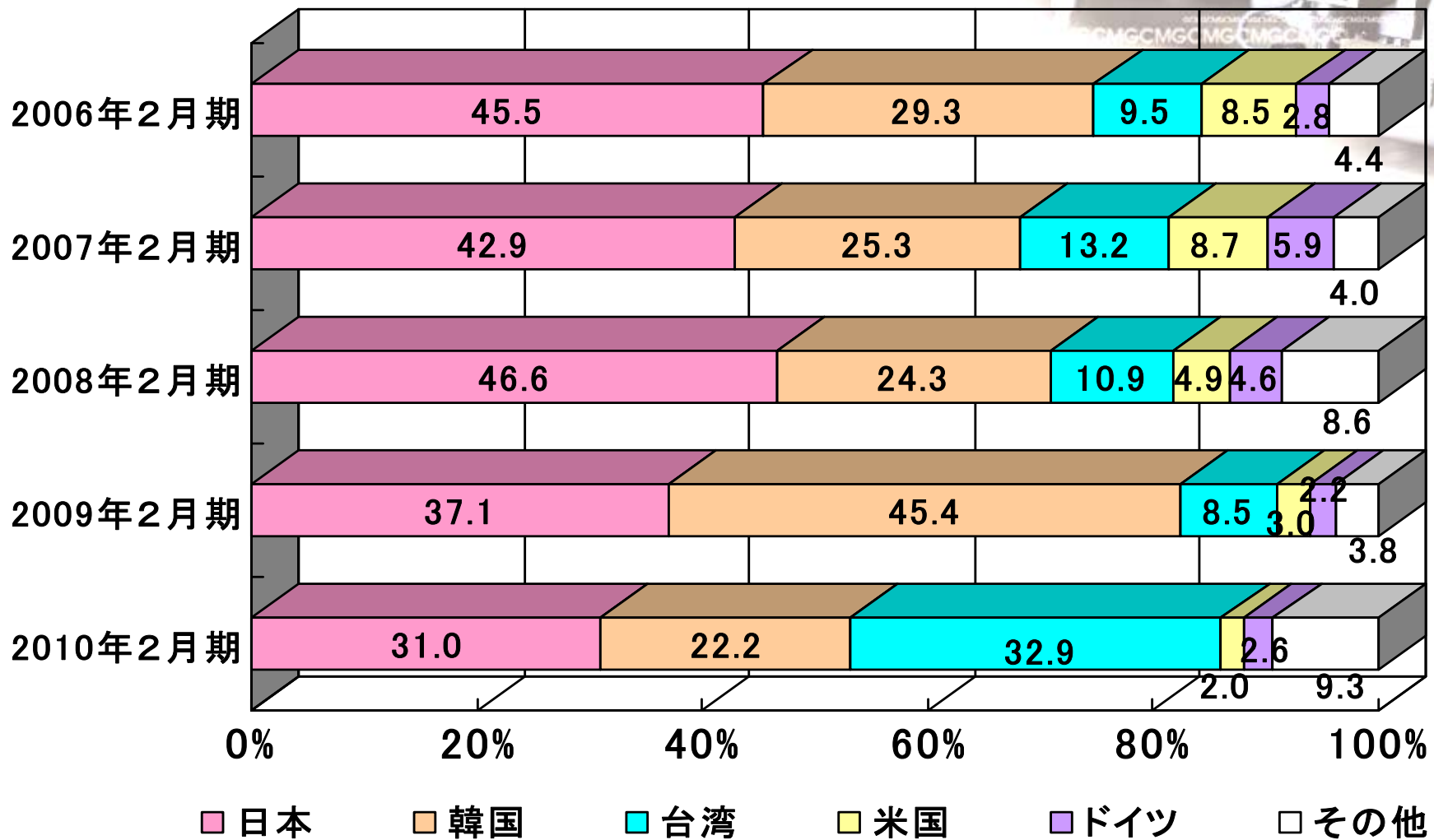
	2009年2月期 実績	2010年2月期 実績	増減率	増減理由等
売上高	4,005	2,163	△46.0%	【減少要因】 ・主に、国内の半導体設備投資の大幅な減少による受注低迷
売上総利益	882	55	△93.7%	【減少要因】 ・売上の大幅な減少
販管費	837	733	△12.4%	【減少要因】 ・人件費を中心とした固定費削減 ・減収に伴う販売関連費用の減少 等
営業利益又は 営業損失(△)	45	△677	—%	
経常利益又は 経常損失(△)	35	△574	—%	(営業外損益の増減につきましては、 決算短信をご参照下さい)
当期純利益又は 当期純損失(△)	3	△370	—%	(特別損益の増減につきましては、 決算短信をご参照下さい)

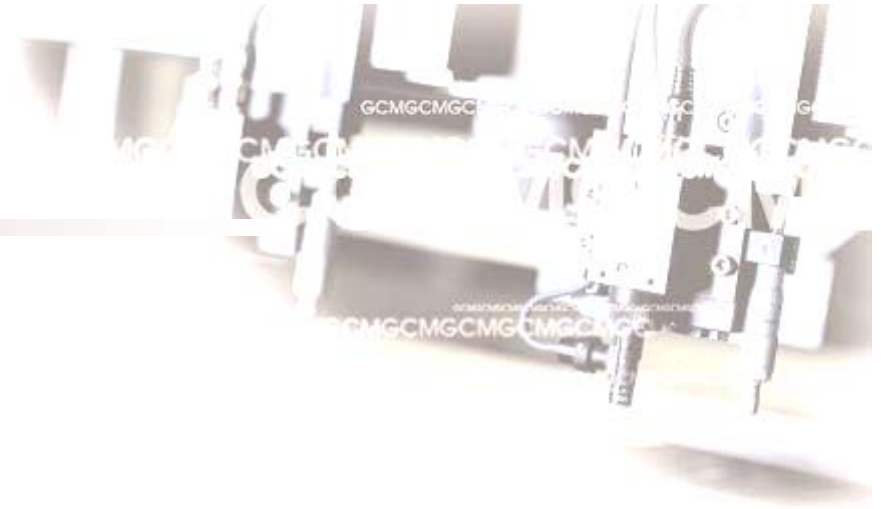
2010年2月期 個別貸借対照表

(百万円)

	2009年2月期 実績	2010年2月期 実績	増減額	増減理由等
流動資産	5,619	4,940	△678	<ul style="list-style-type: none"> ・現金及び預金 +100 ・受取手形及び売掛金 △849 ・たな卸資産 △195 ・関係会社短期貸付金 +253
固定資産	8,142	8,125	△16	<ul style="list-style-type: none"> ・工具、器具及び備品 +112 ・減価償却累計額 △197 ・投資有価証券 +61 ・関係会社長期貸付金 +176
資産合計	13,761	13,066	△695	
流動負債	4,838	4,405	△433	<ul style="list-style-type: none"> ・短期借入金 △518 ・未払金 +102
固定負債	1,756	1,970	213	<ul style="list-style-type: none"> ・長期借入金 +194
負債合計	6,595	6,376	△219	
株主資本	7,138	6,634	△503	<ul style="list-style-type: none"> ・繰越利益剰余金 △405 ・自己株式 △98
評価・換算差額等	28	44	16	
新株予約権	—	11	11	
純資産合計	7,166	6,690	△475	
負債純資産合計	13,761	13,066	△695	

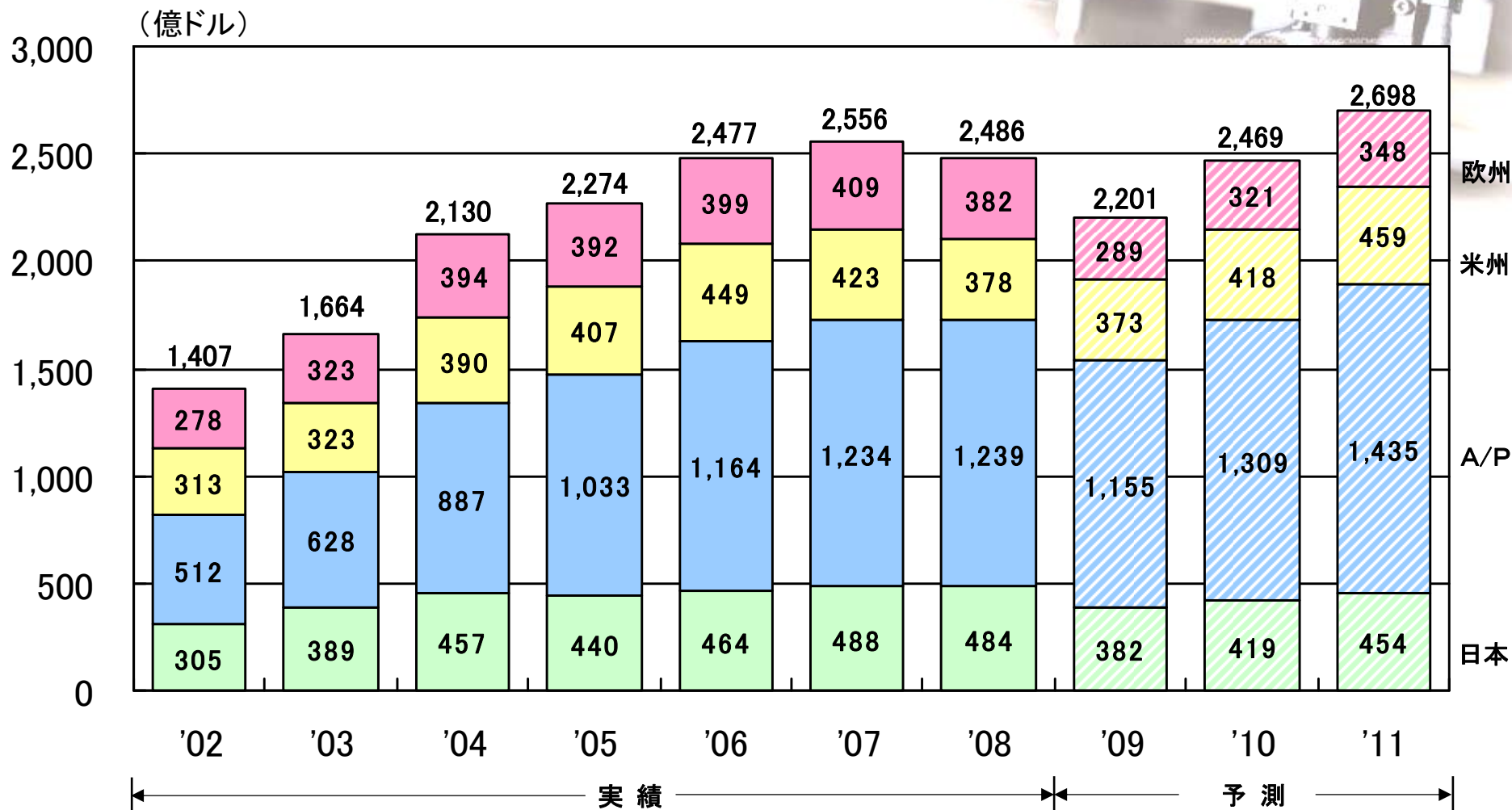
海外売上高(連結)





2011年2月期 業績予想

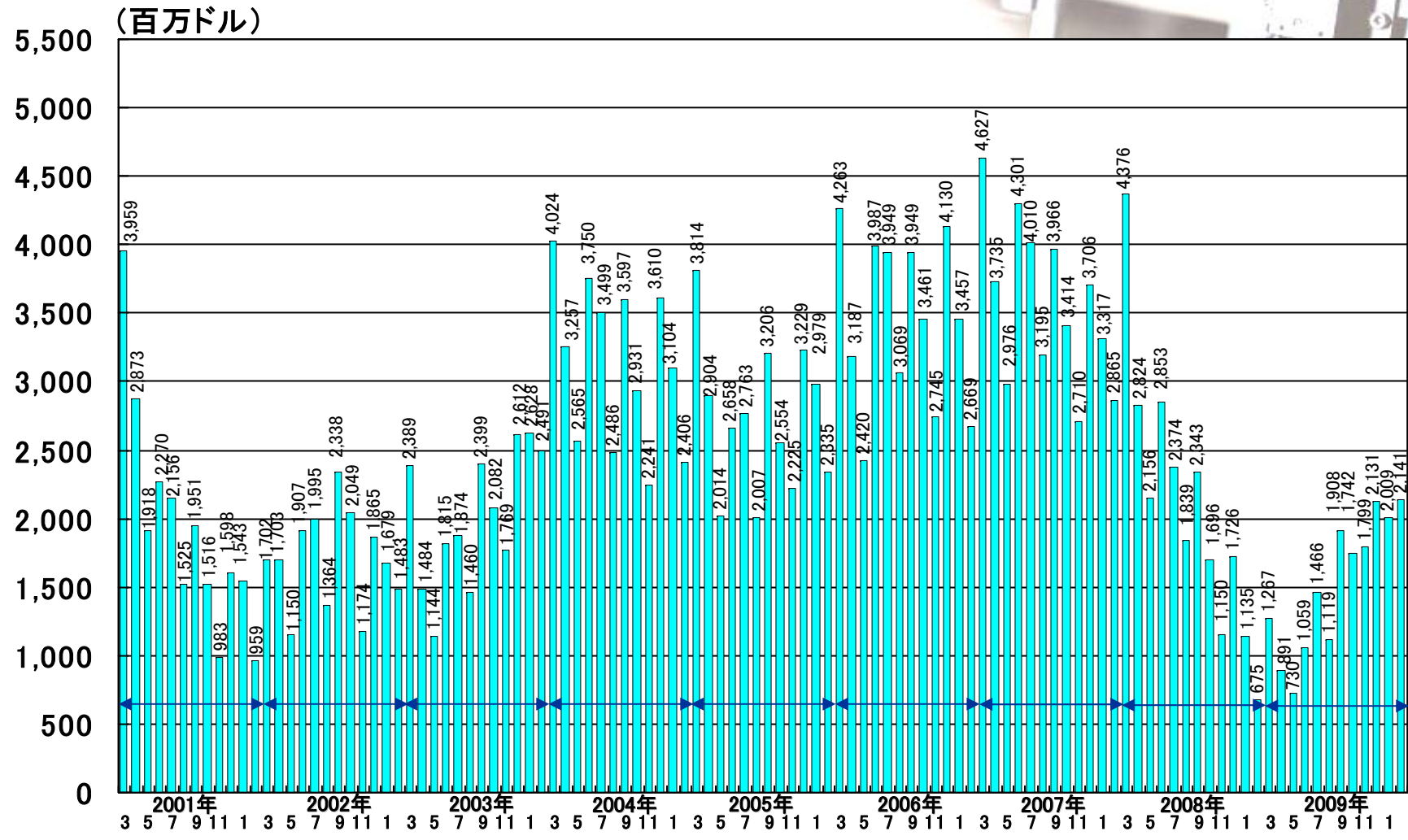
世界の地域別半導体市場規模



注:「A/P」はアジア・パシフィックの略

(出所:2009年12月2日付 半導体産業新聞)(2009年11月 WSTS発表)

世界規模 半導体製造装置販売統計 (2010年2月末現在)



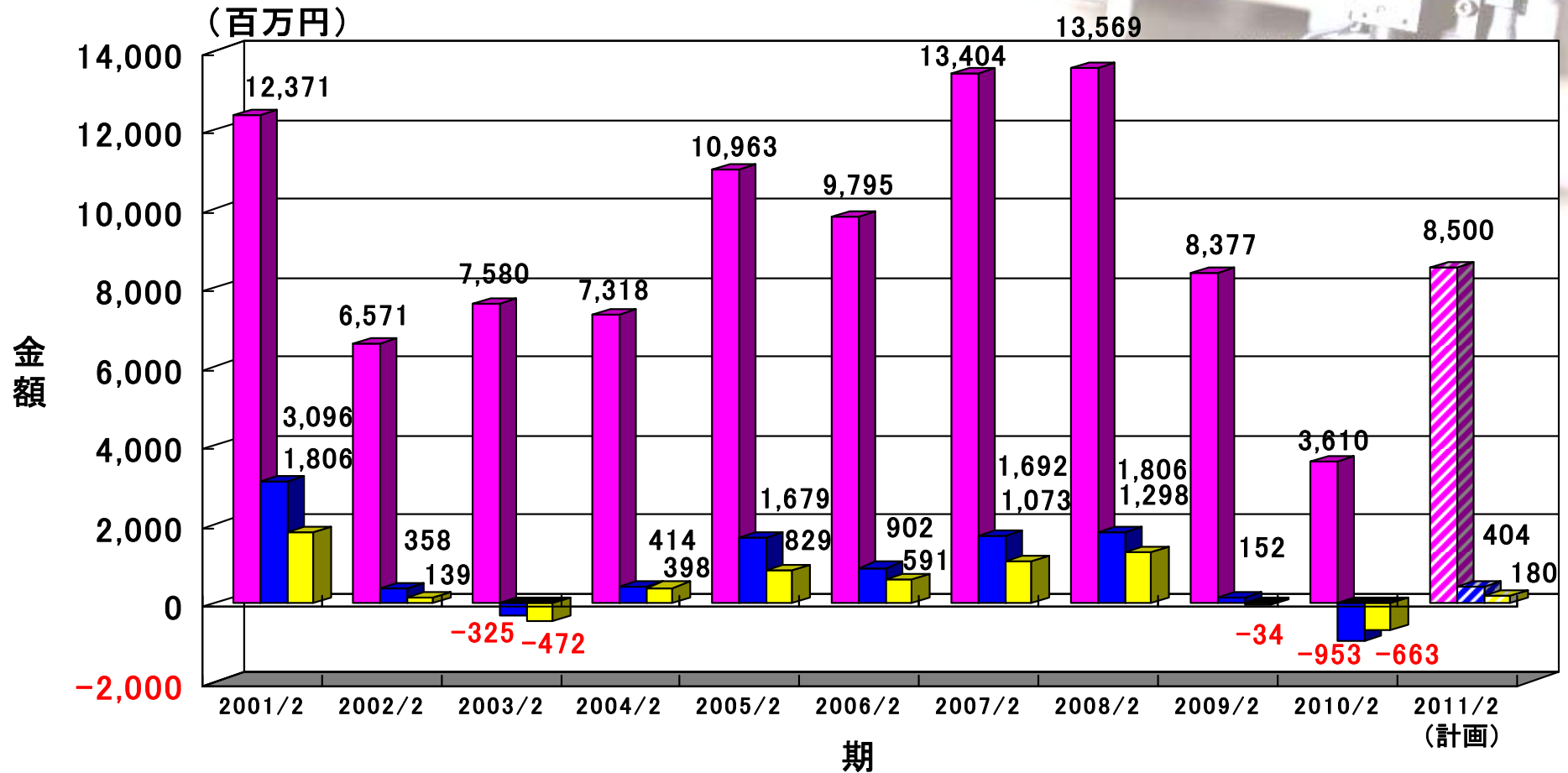
(出所：SEA J, SEMI, SEMIジャパン)

2011年2月期 連結通期業績予想

(百万円)

	2010年2月期 実績	2011年2月期 予想	増減率
売上高	3,610	8,500	135.4%
売上総利益	327	2,192	569.4%
販管費	1,442	1,737	20.4%
営業利益又は 営業損失(△)	△1,115	455	—%
経常利益又は 経常損失(△)	△953	404	—%
当期純利益又は 当期純損失(△)	△663	180	—%

連結業績の推移と今期計画



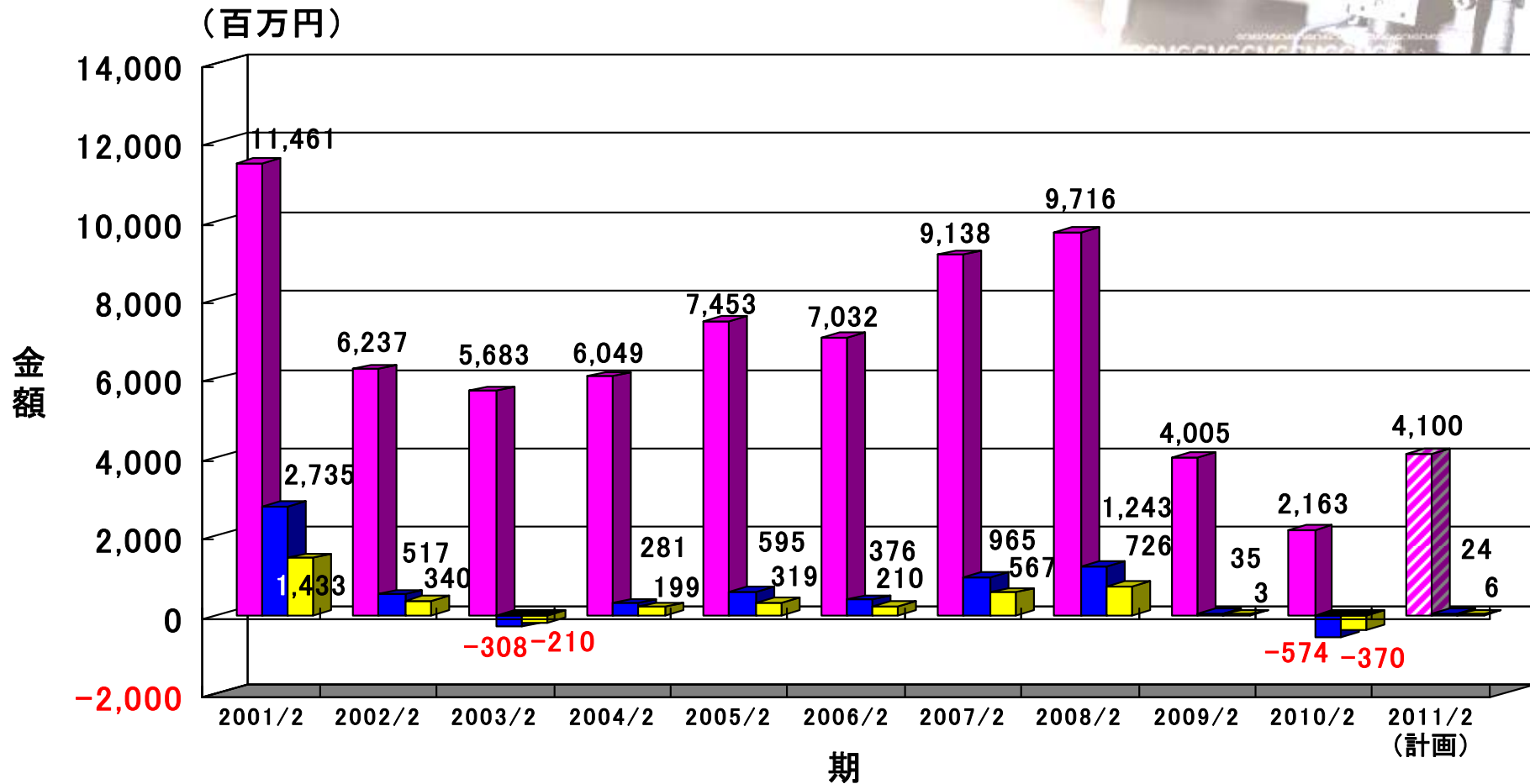
■ 売上高(実績)
 ■ 経常損益(実績)
 ■ 当期純損益(実績)

2011年2月期 個別通期業績予想

(百万円)

	2010年2月期 実績	2011年2月期 予想	増減率
売上高	2,163	4,100	89.5%
売上総利益	55	883	1,480.8%
販管費	733	828	12.9%
営業利益又は 営業損失(△)	△677	55	—%
経常利益又は 経常損失(△)	△574	24	—%
当期純利益又は 当期純損失(△)	△370	6	—%

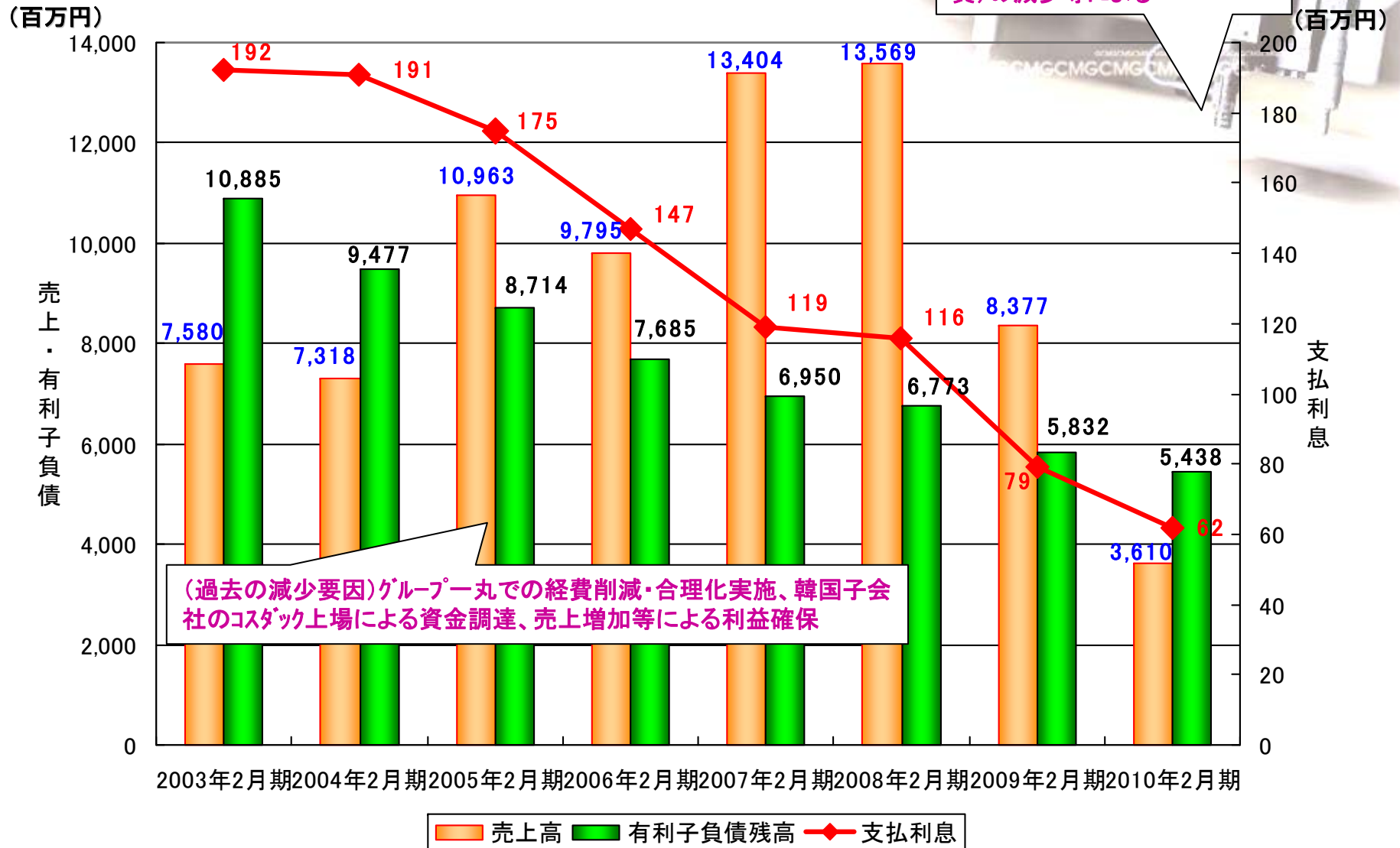
個別業績の推移と今期計画



■ 売上高(実績)
 ■ 経常損益(実績)
 ■ 当期純損益(実績)

有利子負債残高の減少

(2010年2月期減少要因)
前期売掛債権の順調な回収に
加え、当該期の運転資金(需
資)の減少等による





ありがとうございました！

注意事項

この資料は、決算の業績に関する情報及び将来についての計画や戦略、業績に関する予想及び見通しの記述が含まれております。

これらの記述は、当社が現時点で把握可能な情報から判断した見通しや予測であり、その情報の正確性、完全性を保証したり約束したりするものではありません。

また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度等の変化により大きく見通しが変動する可能性があり、今後予告なしに変更されることがあります。